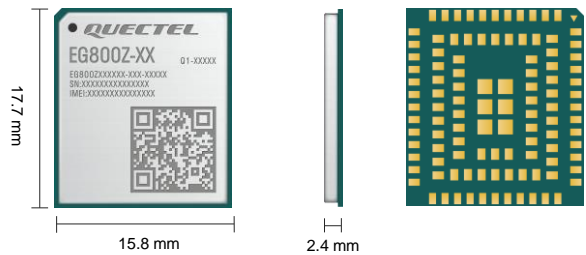




Quectel EG800Z 系列

物联网首选
LTE Cat 1bis 模块



EG800Z 系列是移远通信专为 M2M 和 IoT 领域而设计的 LTE Cat 1bis 无线通信模块，支持最大下行速率 10 Mbps 和最大上行速率 5 Mbps，超小封装，超高性价比。同时，EG800Z 系列在封装上兼容 EC800Z 系列、EC800E 系列、EG810M 系列、EG800K 系列和 EG800G 系列模块。

EG800Z 系列满足不同国家和地区的频段覆盖；模块采用镭雕工艺，镭雕工艺具有外观更好看、金属质感强、散热更好、信息不容易被抹除、更能适应自动化需求等优点。

EG800Z 系列内置丰富的网络协议，集成多个工业标准接口，并支持多种驱动和软件功能（如 Windows 10/ 11、Linux、Android 等操作系统下的 USB 转串口驱动），极大地拓展了其在 M2M 和 IoT 领域的应用范围，如云喇叭、POS、IPC、CPE、数据卡、两轮车、智能安全以及工业级 PDA 等。



主要优势

- ✓ 超小尺寸，专为 M2M 和 IoT 应用设计，尤其是小尺寸终端的需求
- ✓ 支持 DFOTA 远程在线升级，降低后期运维成本
- ✓ 超低功耗
- ✓ 支持 Wi-Fi Scan 定位
- ✓ 支持双卡单待
- ✓ 超高性价比

LTE Cat 1bis
最大 10 Mbps（下行）
最大 5 Mbps（上行）

LGA 封装

内嵌多种网络协议

USB 2.0
高速接口

快速入网
入网速度 2~3s

移远通信增强型
AT 命令

DFOTA

双卡单待

极低功耗
休眠低至 4 μ A

Quectel EG800Z 系列

LTE Cat 1bis	EG800Z-CN	EG800Z-EU	EG800Z-LA
区域/ 运营商	中国/ 印度	欧洲/ 东南亚	拉丁美洲
封装	LGA	LGA	LGA
尺寸 (mm)	17.7 × 15.8 × 2.4	17.7 × 15.8 × 2.4	17.7 × 15.8 × 2.4
重量 (g)	1.2 ±0.1	1.2 ±0.1	1.2 ±0.1
温度范围			
工作温度	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C	-35 °C ~ +75 °C
扩展温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
频段信息			
LTE-FDD	B1 / 3 / 5 / 8	B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28	B2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 28 / 66
LTE-TDD	B34 / 38 / 39 / 40 / 41	B38 / 40 / 41	-
认证			
运营商认证	中国：移动入库 ^① / 电信入库 ^①	-	-
强制认证	中国：SRRC*/ NAL*/ CCC*	欧洲：CE*	美国：FCC ^① 巴西：Anatel ^①
最大数据传输速率			
LTE-FDD (Mbps)	10 (下行) / 5 (上行)	10 (下行) / 5 (上行)	10 (下行) / 5 (上行)
LTE-TDD (Mbps)	8.96 (下行) / 3.1 (上行)	8.96 (下行) / 3.1 (上行)	8.96 (下行) / 3.1 (上行)
接口			
USIM ^②	× 2 (USIM1: 1.8/ 3.0 V; USIM2: 1.8 V)	× 2 (USIM1: 1.8/ 3.0 V; USIM2: 1.8 V)	× 2 (USIM1: 1.8/ 3.0 V; USIM2: 1.8 V)
UART	× 3 (主串口、调试串口、辅助串口*) (QuecOpen® 方案: × 4)	× 3 (主串口、调试串口、辅助串口*) (QuecOpen® 方案: × 4)	× 3 (主串口、调试串口、辅助串口*) (QuecOpen® 方案: × 4)
USB 2.0	× 1	× 1	× 1
PCM*	× 1	× 1	× 1
LCM*	× 1 (QuecOpen® 方案)	× 1 (QuecOpen® 方案)	× 1 (QuecOpen® 方案)
摄像头*	× 1 (QuecOpen® 方案)	× 1 (QuecOpen® 方案)	× 1 (QuecOpen® 方案)
SPI*	× 2 (QuecOpen® 方案)	× 2 (QuecOpen® 方案)	× 2 (QuecOpen® 方案)
PWM*	× 5 (QuecOpen® 方案)	× 5 (QuecOpen® 方案)	× 5 (QuecOpen® 方案)
NET_STATUS	× 1	× 1	× 1
CAN*	× 1 (QuecOpen® 方案)	× 1 (QuecOpen® 方案)	× 1 (QuecOpen® 方案)
ADC	× 2, 12 bits	× 2, 12 bits	× 2, 12 bits
I2C*	× 1 (QuecOpen® 方案: × 2)	× 1 (QuecOpen® 方案: × 2)	× 1 (QuecOpen® 方案: × 2)
LTE/ Wi-Fi Scan 天线	× 1	× 1	× 1
音频*			
语音编解码模式	MP3/ AMR/ WAV	MP3/ AMR/ WAV	MP3/ AMR/ WAV
语音	数字音频、VoLTE (可选)	数字音频、VoLTE (可选)	数字音频、VoLTE (可选)
突出特性			
DTMF*	●	●	●
DFOTA	●	●	●
音频回放/ 音频录制*	○	○	○
QuecFile®	●	●	●
USIM 卡检测	●	●	●
Wi-Fi Scan	●	●	●
软件特性			
协议栈	TCP/ UDP/ NITZ/ FILE/ MQTT/ PING/ NTP/ HTTP/ HTTPS/ SSL/ FTP/ FTPS/ CMUX*/ MMS*/ PPP	TCP/ UDP/ NITZ/ FILE/ MQTT/ PING/ NTP/ HTTP/ HTTPS/ SSL/ FTP/ FTPS/ CMUX*/ MMS*/ PPP	TCP/ UDP/ NITZ/ FILE/ MQTT/ PING/ NTP/ HTTP/ HTTPS/ SSL/ FTP/ FTPS/ CMUX*/ MMS*/ PPP
驱动	RIL	Android 4.x~14.x	Android 4.x~14.x
	RNDIS	Windows 10/ 11, Linux 2.6~6.7	Windows 10/ 11, Linux 2.6~6.7
	ECM	Linux 2.6~6.7	Linux 2.6~6.7
	USB 转串口	Windows 10/ 11, Linux 2.6~6.7, Android 4.x~14.x	Windows 8/ 8.1/ 10/ 11, Linux 2.6~6.7, Android 4.x~14.x
电气特性			
供电电压 ^③	3.3~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3~4.3 V, 典型值 3.8 V	3.3~4.3 V, 典型值 3.8 V
功耗 (典型值)	0.4 μA @ 关机	0.4 μA @ 关机	0.4 μA @ 关机
	4 μA @ PSM (AT+QSClk = 3, USB 断开)	4 μA @ PSM (AT+QSClk=3, USB 断开)	4 μA @ PSM (AT+QSClk=3, USB 断开)
	0.43 mA @ 休眠 (PF = 128)	0.43 mA @ 休眠 (PF = 128)	0.43 mA @ 休眠 (PF = 128)
	0.29 mA @ 休眠 (PF = 256)	0.29 mA @ 休眠 (PF = 256)	0.29 mA @ 休眠 (PF = 256)
	3.8 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 断开)	3.8 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 断开)	3.8 mA @ 空闲 (PF = 64, USB 断开)

备注:

1. *: 正在开发中/ 进行中。
2. ^①: 待定。
3. ^②: 如需使用两路 USIM 接口, USIM1 和 USIM2 须同时使用 1.8 V USIM 卡。
4. ●: 支持。
5. ○: 可选。

